

貳、公司簡介

一、設立日期：民國八十七年四月十五日

二、公司沿革

- | | |
|-----------|---|
| 87 年 04 月 | 公司設立於台北縣板橋市，登記額定資本五億元實收資本一億八仟八百萬元整。 |
| 87 年 06 月 | 於新竹工業區購置土地，並開始動工建廠。 |
| 87 年 07 月 | 高頻積層陶瓷晶片元件研發工作正式開始。 |
| 87 年 09 月 | 取得經濟部工業局核准函，為促進產業升級條例之重要科技事業。 |
| 87 年 09 月 | 向經濟部工業局申請暫緩辦理公開發行核准。 |
| 87 年 11 月 | 辦理現金增資參億壹仟貳佰萬元，增資後資本額增為新台幣五億元整，全額發行。 |
| 87 年 12 月 | 向國內、外申請多項專利。 |
| 88 年 06 月 | 新竹工業區工廠建築物落成並開幕。 |
| 88 年 08 月 | 總公司喬遷至新竹工業區自強路 16 號，佔地 1,234 坪。 |
| 88 年 11 月 | 高頻積層陶瓷晶片元件正式量產。 |
| 88 年 12 月 | 規畫建制並導入企業資源規畫(ERP)系統，以充分掌握資訊時效及正確性。 |
| 89 年 01 月 | 通過經濟部工業局主導性新產品無線通訊產品零組件之補助案。 |
| 89 年 01 月 | 取得 ISO 9001 國際品質認證通過，建立完善品質管理制度並有效控制產品品質。 |
| 89 年 03 月 | 財政部證券暨期貨管理委員會核准增資暨補辦公開發行。 |
| 89 年 05 月 | 在經濟部工業合作小組的支持下，本公司與法商湯姆笙(Thomson-CS)及其子公司 SOREP，簽署無線通訊射頻積層陶瓷模組開發技術移轉，結合兩家既有的材料製程與設計能力，進行射頻積層陶瓷模組開發。 |
| 89 年 06 月 | 辦理現金增資壹億貳仟萬元，增資後實收資本額為新台幣陸億貳仟萬元。 |
| 89 年 07 月 | 法商湯姆笙公司成為本公司法人董事。 |
| 89 年 12 月 | 取得美國、中華民國多項專利權。 |
| 90 年 05 月 | 取得經濟部工業局核准函，為促進產業升級條例之新興重要策略性產業。 |
| 90 年 08 月 | 取得 QS 9000 國際品質認證通過。 |
| 90 年 10 月 | 本公司榮獲經濟部頒布「90 年度第八屆中小企業創新研究獎」。 |
| 90 年 12 月 | 取得經濟部工業局主導性新產品「微小化雙頻開關陶瓷模組」之補助案。 |
| 91 年 03 月 | 成功開發無線區域網路(WLAN)整合元件並量產銷售。 |
| 92 年 01 月 | 成功開發藍芽模組之製程技術。 |
| 92 年 10 月 | 本公司榮獲經濟部頒布「92 年度第十屆中小企業創新研究獎」。 |
| 93 年 04 月 | 取得 ISO 14001 環境管理系統認證通過。 |
| 93 年 07 月 | 盈餘轉增資肆仟肆佰陸拾柒萬陸千元，增資後實收資本額為新台幣陸億陸仟肆佰陸拾柒萬陸千元。 |

- 93 年 08 月 本公司榮獲經濟部頒布「93 年度第七屆小巨人獎」。
- 93 年 10 月 本公司榮獲經濟部頒布「93 年度第十三屆國家磐石獎」。
- 93 年 12 月 股票於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌興櫃買賣。
- 94 年 07 月 盈餘轉增資陸仟柒佰伍萬參仟參佰貳拾元，增資後實收資本額為新台幣柒億參仟壹佰柒拾貳萬玖仟參佰貳拾元。
- 95 年 09 月 盈餘轉增資壹億伍佰肆拾伍萬伍仟壹佰貳拾元，增資後實收資本額為新台幣捌億參仟柒佰壹拾捌萬肆仟肆佰肆拾元。
- 95 年 10 月 現金減資參億參仟肆佰捌拾柒萬肆仟肆佰肆拾元，減資後實收資本額為新台幣伍億貳佰參拾壹萬元。
- 95 年 12 月 取得經濟部業界開發產業技術計畫「無線通訊積層陶瓷模組的無收縮燒結製程開發計畫」之補助案。
- 96 年 06 月 盈餘轉增資肆仟零貳拾萬壹仟肆佰元，增資後實收資本額為新台幣伍億肆仟貳佰伍拾壹萬壹仟肆佰元。
- 96 年 12 月 員工認股權執行發行新股貳佰柒拾萬元，實收資本額增為新台幣伍億肆仟伍佰貳拾壹萬壹仟肆佰元。
- 97 年 03 月 股票初次上櫃現金增資陸仟捌佰壹拾玖萬元，增資後實收資本額增為新台幣陸億壹仟參佰肆拾萬壹仟肆佰元。
- 97 年 03 月 股票於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。
- 97 年 07 月 盈餘轉增資壹仟肆佰零壹萬捌仟陸佰元，增資後實收資本額為新台幣陸億貳仟柒佰肆拾貳萬元。
- 97 年 10 月 本公司榮獲經濟部頒布「97 年度第十六屆優等創新企業獎」，總經理同時榮獲經濟部頒布「97 年度第十六屆前瞻技術創新獎」。
- 98 年 03 月 成功開發 2G 手機 SiP 模組並量產銷售。
- 99 年 09 月 資本公積轉增資陸仟貳佰柒拾肆萬貳千元，增資後實收資本額為新台幣陸億玖仟零壹拾陸萬貳千元。
- 99 年 12 月 取得社團法人中華公司治理協會 CG6006 通用版公司治理制度評量認證。
- 100 年 07 月 本公司榮獲「第八屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級。
- 100 年 08 月 本公司榮獲富比士「Asia's Best under a Billion」。
- 100 年 11 月 成功開發 3G 手機 SiP 模組並量產銷售。
- 101 年 03 月 成功開發 WLAN SiP 模組並量產銷售。
- 101 年 07 月 本公司榮獲「第九屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級。
- 102 年 07 月 本公司榮獲「第十屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級。
- 103 年 01 月 本公司榮獲經濟部第二屆中堅企業重點輔導對象。
- 103 年 07 月 本公司榮獲「第十一屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級。
- 104 年 04 月 本公司榮獲「第十二屆上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級暨「第一屆公司治理評鑑」整體排名前百分之二十公司。
- 105 年 04 月 本公司榮獲「第二屆公司治理評鑑」整體排名前百分之五公司。

- 106 年 01 月 取得 OHSAS 18001 職業安全衛生系統認證通過。
- 106 年 04 月 本公司榮獲「第三屆公司治理評鑑」整體排名前百分之二十公司。
- 106 年 11 月 於新竹工業區新廠開始動工興建。
- 106 年 12 月 取得美國、中華民國多項專利權。
- 107 年 04 月 本公司榮獲「第四屆公司治理評鑑」整體排名前百分之二十公司。
- 107 年 07 月 取得 IATF 16949 品質管理系統認證通過。
- 108 年 02 月 取得經濟部 A+企業創新研發淬鍊計畫「前瞻技術研發計畫」之補助案。
- 108 年 04 月 本公司榮獲「第五屆公司治理評鑑」整體排名前百分之五公司。
- 109 年 04 月 本公司榮獲「第六屆公司治理評鑑」整體排名前百分之五公司。
- 109 年 12 月 取得 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證通過。
- 110 年 04 月 本公司榮獲「第七屆公司治理評鑑」整體排名前百分之五公司。
- 111 年 04 月 本公司榮獲「第八屆公司治理評鑑」整體排名前百分之五公司。
- 112 年 04 月 本公司榮獲「第九屆公司治理評鑑」整體排名前百分之五公司。